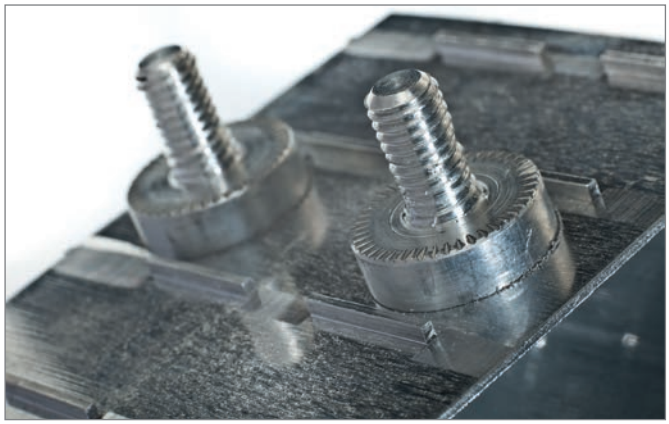
TELSONIC
ULTRASONICS

응용 사례

딥드로잉 부품에 고정핀



이 적용 영역은 토셔널 SONIQTWIST® 기술을 통해 용착되었습니다. 위는 토셔널 용착 설비 TSP3000.

과제

알루미늄 판에서 전자제품을 수용하기 위한 하우징을 딥드로잉 공정으로 제작해야 합니다. 따라서 제작된 하우징에는 고정부가 없는 매끈한 표면만 존재합니다. 이런 이유에서 나사핀 또는 특수 절곡 서포트 레일을 추가적으로 하우징 부분에 부착해야 합니다.

솔루션

원형, 사각형 또는 직각형 형태의 용착할 고정부 또는 서포트 레일 전체가 토셔널 SONIQTWIST® 기술을 통해 TSP3000 타입 설비에서 용착되거나 또는 상응하는 컴포넌트로 신속하고 안전하게 하우징에 용착됩니다.

이 구성의 이점

토셔널 SONIQTWIST® 기술은 복잡한 형상의 부품도 안전하고 신속하게 용착할 수 있으며 이때 부품은 과도한 열에 노출되지 않습니다. 넓은 면의 부품도 점 형태로 결합할 수 있습니다. 각 용착에 대한 공정 매개변수는 수집되므로 용착 품질에 대한 추적성을 확보할 수 있습니다. 공정 제어장치 는 포괄적인 데이터 수집 및 평가 옵션을 제공합니다.

2402 / ko / © TELSONIC AG / 기술적 변경 가능